

ENCUENTRO TÉCNICO 8 DE ABRIL DE 2011

USO DE RESINAS DE BAJO PESO MOLECULAR COMO BARNICES



PROGRAMA:

08:30-09:30h. Recepción de asistentes y entrega de documentación

09:30-10:00h. Presentación del acto. Jorge García (MNCARS), Marián del Egido (IPCE) y Ruth Chércoles (GE-IIC)

10:00-11:30h. **René de la Rie** (National Gallery of Art, Washington D.C)

Propiedades de las resinas utilizadas como barnices de retoque I.

¿Por qué utilizar un barniz?

Barnices tradicionales.

Propiedades ópticas.

Degradación de barnices.

11:30-12:00h. Descanso

12:00-13:00h. **René de la Rie** (National Gallery of Art, Washington, D.C)

Propiedades de las resinas utilizadas como barnices de retoque II.

Estabilización con antioxidantes

Barnices poliméricos

Síntesis de barnices de bajo peso molecular

Barnices de retoque

13:00-13:30h. Preguntas y debate

13:30-15:00h. Comida

15:00-16:00h. **Ana Ordóñez y Lourdes Domedel** (Centro de Restauración de Bienes Muebles de Cataluña)

Experiencia y prácticas de taller en la aplicación tanto de barnices tradicionales como de bajo peso molecular

16:00-17:30h. **Foro abierto**

Participación de distintos profesionales en el campo de Conservación y Restauración del Patrimonio

Habrà un servicio de traducción simultànea inglès-español para los asistentes

Lugar: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. Auditorio 400, acceso por Ronda de Atocha s/n

Matrícula: 50 € (25 € socios del GEIIC, 35 € estudiantes)

Reserva de plaza: Secretaría del GEIIC [cursos@ge-iic.org](mailto: cursos@ge-iic.org) www.ge-iic.com Tel. 618279279

Se ruega reservar plaza por correo-e o teléfono antes de efectuar el ingreso bancario y enviar el justificante de pago por correo o mail, indicando nombre, apellidos, teléfono o correo-e, lugar de trabajo y tipo de matrícula.

El pago de la matrícula se puede realizar también a través de la página web.

Los estudiantes deberán acreditar su condición presentando un carnet o certificado de estudios.

Datos bancarios: BSCH nº 0049 2150 42 2594025932, Titular: GEIIC, Concepto: Encuentro Técnico